

中信证券股份有限公司
关于
长江存储控股股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
上市保荐书

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二六年八月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
一、发行人概况	3
二、申请上市股票的发行情况	12
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况	12
四、保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明	15
五、保荐人承诺事项	16
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序	17
七、保荐人关于发行人符合科创板定位要求的核查意见	17
八、保荐人对发行人是否符合科创板上市条件的说明	19
九、保荐人对发行人持续督导工作的安排	23
十、保荐人认为应当说明的其他事项	23
十一、保荐人对本次股票上市的推荐结论	24

一、发行人概况

（一）发行人基本资料

公司名称：长江存储控股股份有限公司

英文名称：CCSH Corporation

统一社会信用代码：91420100MA4KQ9MW0P

注册资本：1,782,000.00 万元人民币

法定代表人：陈南翔

有限公司成立日期：2016 年 12 月 21 日

股份公司成立日期：2025 年 9 月 25 日

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 1701 室

邮政编码：430205

联系电话：027-65529696

传真号码：027-65529697

互联网址：www.ccsb.com

电子信箱：ir@ccsb.com

经营范围：一般项目：企业管理；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本次证券发行的类型：首次公开发行股票并在科创板上市

公司董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理事务，负责人为李刚，联系电话 027-65529696。

（二）主营业务情况

公司是代表中国跻身世界一流的存储器 IDM 企业，打造全球领先层数、高

存储密度、高 I/O 速度的 NAND Flash 系列产品，广泛应用于企业服务器、数据中心、消费电子等领域。依托中国庞大的应用市场和国际化布局，报告期内公司出货量快速增长，根据 TrendForce 数据计算，2026 年 1-3 月公司在全球 NAND Flash 厂商中按销售金额和出货量排名，均位列全球第三、中国第一。

公司始终坚持原创核心技术攻关，引领我国 3D NAND 技术赶超国际先进水平。公司 2022 年推出 Xtacking®3.0 技术，获得全球存储领域权威峰会 FMS “最具创新存储技术奖”，成为全球首批推出 200 层以上 3D NAND Flash 产品的企业，实现国内存储技术首次领先世界先进水平；2024 年迭代 Xtacking®4.0 技术，次年再度获得 FMS 权威奖项，重塑全球 3D NAND 技术发展路线；2025 年成为中国大陆为数不多的与国际头部厂商达成专利交叉授权的集成电路企业，技术影响力凸显。

公司已构建多元高质量客户体系，实现多维度、多层级市场覆盖。在企业用户市场，公司与国内互联网、服务器、消费电子等领域头部企业深度合作，同时切入国际一流客户供应体系。在个人用户市场，公司推出自有品牌致态®系列产品，品牌知名度与市场影响力持续提升。

存力是数字时代的基石，是数字基建的核心载体。公司以终端应用为牵引，持续构建高商业价值产品组合，支撑各细分领域、应用场景多元需求。同时，公司为上游材料、设备、零部件厂商提供应用验证场景，与上下游商业伙伴共同推动全产业链技术迭代、工艺升级，做大做强中国存储器产业，以科技创新服务回馈社会。

（三）发行人核心技术

公司作为代表中国跻身世界一流的存储器 IDM 企业，核心技术覆盖 NAND Flash 产品设计、工艺、封测等环节，具有独立自主的技术路线和技术体系。

公司具有代表性的核心技术主要包括 3D NAND 晶圆技术和 3D NAND 产品技术，核心技术具体情况如下：

1、3D NAND 晶圆技术

序号	类别	技术名称	技术概况及先进性表征	先进性	专利
1	3D NAND 技术	Xtacking®架构技术	全球首创 Xtacking®架构,依托分合、共享、重构与正反的核心理念,在 Xtacking®架构 1.0~4.0 的演进过程中实现了异质集成、同质多堆栈堆叠、晶背信号与电源引出、无台阶自对准字线引出多项架构创新,从本质上解决了氢热耦合矛盾和超高层工艺集成难题,开辟了三维闪存技术新路径,为 3D NAND 闪存迈向更高层提供了核心技术支持。其中: ①异构集成是将存储阵列与外围电路通过异质混合键合集成,采用新型铜机械研磨工艺、背面应力补偿工艺与光刻修正技术,开发新型绝缘介质材料,实现了百亿根铜通孔亚微米级对准精度的互连,键合密度领先业界同期一个数量级; ②同质多堆栈阵列架构解决刻蚀设备能力不足的问题,在同等设备能力下存储密度大幅提升; ③晶背信号与电源引出将三维架构底部的复杂三维工艺变为平面工艺,显著降低了集成难度和制造成本,解除了垂直深槽底部立体工艺对三维闪存向更高层数堆叠发展的限制; ④无台阶自对准字线形成与引出架构,通过自对准接触孔代替传统台阶字线引出技术,解决传统架构中台阶字线引出在向更高层数迭代中导致的平面存储面积损失和多维工艺牵制问题,显著提升存储密度; 获得未来内存与存储峰会(FMS)“最具创新存储技术奖”;全球闪存峰会(FMW)“闪存存储创新产品特别奖”;中国闪存市场峰会(CFMS)“最佳技术突破奖”。	国际领先	发明专利 2,000 项以上
2	MLC 3D NAND	多阶存储单元调控技术	自主研发了多阶存储单元调控技术,针对纳米尺度多叠层栅介质结构进行原子级精准调控,解决电荷俘获器件基础科学问题,控制数据失效比在极低水平,实现 2bit 存储,应用于第一代 3D NAND 产品。	国际先进	发明专利 350 项以上
3	TLC 3D NAND	栅堆栈能带调控理论方法	通过引入栅堆栈能带调控理论方法,有效解决了层数增加带来的层间耦合效应,显著提升了产品可靠性,实现 3bit 存储,应用于第二至第五代 3D NAND 产品。	国际先进	
4	QLC 3D NAND	新型自适应编程、阶梯式电势调控	创新性地提出新型自适应编程、阶梯式电势调控等阵列操作算法,有效解决了存储阵列连接区的器件串扰问题,实现 4bit 存储。应用于第三至第五代 3D	国际先进	

序号	类别	技术名称	技术概况及先进性表征	先进性	专利
		等阵列操作算法	NAND 产品。		

2、3D NAND 产品技术

序号	类别	技术名称	技术概况及先进性表征	先进性	专利
1	硬件设计	硬件电路设计与可靠集成技术	在供电方案、备电电路、大容量架构、高速接口、高速高密互连、极限尺寸结构堆叠、热设计及可靠性设计等方向，沉淀了丰富的标准电路和成熟设计方案，保障 UFS、SSD 等产品硬件设计完整可靠。具备完善的多物理场联合仿真技术，高效破解信号传输、电磁兼容、散热、机械环境适配等各类技术难题，推动产品硬件综合性能与可靠性达到国际一流水平。	国际先进	发明专利 10 项以上
2	嵌入式	嵌入式 eMMC、UFS 产品技术	通过写入增强技术，主机缓存加速，多级自主优化等定制化固件设计，依托从控制器定制化到 NAND 特性级别的优化，提升产品存储效率和性能。通过自主研发的多模态低功耗模式，显著降低产品功耗。自主开发 UFS2.2、UFS3.1、UFS4.1 等多款产品。	国际先进	发明专利 20 项以上
3	消费级	消费级 PCIe Gen4、Gen5 产品技术	拥有行业领先的 PCIe 无缓（DRAM-less）SSD 软硬件设计，包括高顺序读写性能设计、低功耗策略、主机缓存方案（HMB）、冗余数据保护（RAID）算法等多项核心技术，实现办公、影音、游戏等多场景和高负载、冷启动等多工作模式下的性能优化，持续推出 PC411、PC450、PC41Q、PC550 等多款 OEM 商用消费级产品，产品性能同代领先。	国际先进	发明专利 20 项以上
4	企业级	企业级 PCIe Gen4、Gen5 产品技术	针对企业级高稳定性、高可靠性需求，拥有一系列介质优化算法如谷底电压搜索、数据保持刷新、纠错流程等算法，使闪存颗粒在性能、数据可靠性等方面发挥出最佳特征。具备体系化的功耗评估模型和功耗优化方法论，通过一系列创新的硬件设计和散热结构的优化，配合固件算法，实现行业领先的功耗管理。 基于 Xtacking®4.0 架构 3D NAND 推出 PCIe Gen5 高性能企业级 SSD 产品，具备行业领先的性能和可靠性设计。	国际先进	
5	封装	多层堆叠封装技术	通过多层堆叠封装技术（DDP/QDP/ODP/HDP/32DP），实现单颗粒容量涵盖 512GB~8TB。其中通过晶圆厚度减薄及精准切割技术实现两位数芯片堆叠封装，为目前业界最大容量存储芯片封装，且封装后产品实现业界体积最小。广泛应用于智能手机、电脑、企业级服务器，互联网设备等场景。	国内领先	发明专利 160 项以上

（四）科研实力和成果情况

1、主要荣誉奖项

截至 2026 年 3 月 31 日，公司获得的主要荣誉、奖项情况如下：

获得时间	获奖主体	颁发部门	荣誉名称
2026 年 3 月	长江存储	中国闪存市场峰会（CFMS）	年度技术创新奖
2025 年 8 月	长江存储	未来内存与存储峰会（FMS）	最具创新存储技术奖
2025 年 5 月	长江存储	德国红点奖委员会	红点设计奖
2025 年 3 月	长江存储	中国电子学会	技术发明奖特等奖
2025 年 3 月	长江存储	中国闪存市场峰会（CFMS）	年度闪存技术创新奖
2025 年 3 月	长江存储	国际半导体产业协会	可持续发展卓越贡献奖
2024 年 3 月	长江存储	中国闪存市场峰会（CFMS）	年度技术突破奖
2023 年 3 月	长江存储	中国闪存市场峰会（CFMS）	最佳技术突破奖、最佳行业价值贡献奖
2022 年 8 月	长江存储	世界闪存峰会（FMS）	最具创新存储技术奖
2021 年 9 月	长江存储	中国闪存市场峰会（CFMS）	最佳市场突破奖
2021 年 7 月	长江存储	全球闪存峰会（FMW）	十大固态硬盘企业金奖、闪存存储创新产品特别奖
2018 年 9 月	长江存储	中国闪存市场峰会（CFMS）	最佳技术创新奖
2018 年 8 月	长江存储	世界闪存峰会（FMS）	最具创新初创闪存企业奖
2022 年 10 月	宏茂微	上海市科学技术委员会	上海市科技小巨人企业

2、重大科研项目及主要在研项目

自成立以来，公司牵头或参与了多个重大科研项目。截至 2026 年 3 月 31 日，公司主要在研项目情况如下：

序号	名称	所处阶段	研发目标
1	第六代三维闪存系列产品研发项目	研发阶段	完成公司多个第六代三维闪存产品研发
2	三维闪存系统解决方案产品研发系列项目	研发阶段	进一步完善公司系统解决方案产品固件和硬件技术平台，并基于公司第五代三维闪存产品，开发具有更高性能、更低延迟、更大容量、更低功耗的存储器产品，包括：①面向企业级服务器的 PCIe Gen5 和 SATA eSSD 产品等；②面向消费电子领域的 PCIe Gen5 cSSD 产品、UFS3.1 和 UFS4.1 嵌入式存储产品等

3、研发投入情况

报告期内，公司保持较高的研发投入水平，研发投入及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年	2024 年	2023 年
研发投入	176,312.62	558,459.15	429,438.65	431,048.67
营业收入	4,704,231.49	6,318,462.42	4,520,321.51	1,874,380.21
研发投入占比营业收入	3.75%	8.84%	9.50%	23.00%

4、合作研发情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司不存在正在从事的重要合作研发项目。

（五）主要财务数据及指标

报告期内，发行人主要财务数据及指标如下：

单位：万元

项目	2026.3.31/ 2026 年 1-3 月	2025.12.31/ 2025 年	2024.12.31/ 2024 年	2023.12.31/ 2023 年
资产总额	26,158,847.11	22,839,616.25	21,102,416.29	19,787,856.63
归属于母公司所有者权益	13,577,750.41	10,236,556.13	8,608,153.04	7,576,074.55
资产负债率（合并）	43.65%	50.14%	56.83%	61.30%
资产负债率（母公司）	0.90%	0.72%	0.06%	0.11%
营业收入	4,704,231.49	6,318,462.42	4,520,321.51	1,874,380.21
归属于母公司所有者净利润	3,337,887.88	1,421,073.80	677,074.52	-1,918,064.00
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者净利润	3,317,215.49	1,330,909.72	622,964.02	-1,935,986.21
基本每股收益（元/股）	1.87	0.80	0.39	-1.23
稀释每股收益（元/股）	1.87	0.80	0.39	-1.23
加权平均净资产收益率	28.03%	15.08%	8.23%	-27.68%
经营活动产生现金流量净额	2,674,405.47	3,268,357.89	2,172,071.60	98,869.76
现金分红	-	-	-	-
研发投入占营业收入比例	3.75%	8.84%	9.50%	23.00%

（六）发行人面临的主要风险

1、与发行人相关的风险

（1）经营风险

1) 人才短缺或流失风险

半导体存储器行业属于人才密集型产业，具有丰富行业经验的研发、生产、采购、销售、运营管理团队是公司保持竞争力的关键。在国家政策大力支持下，

我国集成电路产业蓬勃发展，对优秀人才需求与日俱增。未来，若公司核心团队流失、优秀人才短缺或人员能力未能匹配公司业务发展的需要，可能对公司业务开展造成不利影响。提请投资者注意相关风险。

2) 商业秘密泄露风险

半导体存储器行业属于技术密集型产业，核心技术、制造工艺等商业秘密是公司保持竞争优势的关键因素。虽然公司已建立较为完善的知识产权保护体系和严格的保密制度，但考虑到全球存储芯片行业激烈竞争背景、商业秘密保护措施的限制性、人员流动等其他不可控因素，公司商业秘密仍存在泄露风险。如该等情况发生，将对公司市场竞争力造成不利影响。提请投资者注意相关风险。

3) 产能区域集中度较高风险

公司是集芯片设计、晶圆制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的存储器 IDM 企业，在多地设有产研基地。基于半导体产业集聚发展、配套协同优化、降低运营成本、提升生产协同效率的布局逻辑，截至本上市保荐书签署日，公司核心晶圆制造产能相关的主要经营性资产均位于武汉区域，地理分布距离近、区域集中度较高。若未来公司核心晶圆产能所处地区的电力、能源、水等资源供应、环保或安全生产、公共配套保障、区域性公共突发事件、不可预测的灾害（如地震、洪涝、火灾等）等出现不利情形，可能导致制造流程中止甚至精密设备损坏，从而可能带来产能及产能利用率波动、产品交付延期、生产运营成本上升等问题。提请投资者注意相关风险。

(2) 财务风险

1) 持续高额投入风险

存储芯片行业具有持续高投入特点。存储芯片行业产品、技术、工艺迭代速度较快，企业需对行业发展趋势、产品布局、技术路线进行预判并以巨额资金投入前瞻性研发。报告期内，公司累计研发支出约 159.53 亿元。同时，产品供应能力和价格是核心竞争因素，规模效应是降低单位成本的主要手段之一。报告期内，公司购建长期资产累计现金支出约 963.90 亿元。但公司产能规模与国际存储巨头仍存在差距，未来一段时间仍需保持高额产能建设及产线升级投入，投产后将产生高额折旧摊销费用。报告期内，公司折旧及摊销费用合计约 509.49 亿

元，为营业成本和期间费用的主要构成部分。

若公司未能从生产经营或其他渠道获得足够资金，可能无法支撑公司前述持续高额投入需求。若未来公司不能及时推出在性能、质量、成本等方面具有综合竞争力的产品，或研发方向出现误判、产品和工艺迭代速度不及预期，将可能在激烈的市场竞争中落后于国际巨头并丧失市场份额。若未来存储芯片技术、市场需求等因素发生重大不利变化，亦可能导致公司花费巨额投入的新产品、新技术、新工艺、新产能无法实现预期商业效益，进而对公司经营业绩造成不利影响。提请投资者注意相关风险。

2) 价格及毛利率波动和下滑风险

历史上存储芯片行业受供需影响具有周期性波动特点。需求端，下游主要应用领域受技术迭代、国内外经济状况、消费水平、新兴产业发展等因素影响；供给端，存储芯片行业集中度高，产能建设投资大，产能释放和压降需要一定周期，主要供应商产能调整可能对市场供应量构成较大影响。产能集中释放可能在短期内导致市场供给过剩，进而引发产品单价下跌。同时规模庞大且相对稳定的折旧摊销费用将在一定程度上放大单价波动对毛利率及净利润的影响。

截至本上市保荐书签署日，全球 NAND Flash 市场处于供不应求的高景气周期，公司毛利率及净利润规模随之快速上升。但 NAND Flash 市场高景气度持续时间存在不确定性。当市场需求增速放缓或主要存储厂商快速扩产及重新调配产能导致供给大幅增加时，产品价格可能出现回落。同时，公司直面与国际巨头的激烈竞争，国内外经济形势、产品技术发展状况、原材料及设备供应情况、地缘政治等多方面因素均可能影响公司业绩表现，导致公司毛利率、净利润水平明显波动、甚至亏损。提请投资者注意相关风险。

3) 存货减值风险

报告期内，公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额分别为 113.53 亿元、1.16 亿元、6.93 亿元和 2.49 亿元。若未来出现客户违约，或产品价格显著下降等情况，可能导致公司需计提大额存货跌价准备。提请投资者注意相关风险。

(3) 合规和法律风险

1) 安全生产风险

公司产品制造过程涉及近千步工艺步骤,需使用具有一定危险性的材料及气体。公司高度重视并已建立了严格的安全生产、健康与环境管理制度、规范及体系,对厂区内人员开展系统性培训,但仍存在相关制度执行不到位发生意外事故、故障等风险。提请投资者注意相关风险。

2) 环境保护风险

公司生产过程涉及产生废气、废水、固体废物等污染物。公司拥有相匹配的环保装置和防护措施,报告期内整体运行情况良好。但如未来环保设施运行发生意外故障或有关环境保护制度执行不到位等均可能导致环境污染事件。提请投资者注意相关风险。

3) 诉讼纠纷风险

半导体产业属于典型的知识产权密集型行业。公司坚持自主创新,高度重视公司知识产权及商业秘密。但全球存储芯片行业竞争激烈,涉及利益相关方较多,并受国际政治因素影响。国际巨头亦将知识产权诉讼、收取知识产权费用等作为竞争甚至创收手段之一。公司在经营过程中存在与竞争对手等相关方产生诉讼纠纷的可能。提请投资者注意相关风险。

2、与行业相关的风险

(1) 地缘政治摩擦风险

存储芯片制造对原材料、设备及备品备件要求较高,全球半导体产业链已形成高度专业化协同分工体系。近年来国际贸易政策不稳定因素增加,若相关情况发生重大不利变化,可能对公司供应链和生产经营稳定性、产品成本控制以及海外市场开拓等方面造成不利影响。提请投资者注意相关风险。

3、其他风险

(1) 募投项目相关风险

公司已对本次募集资金投资项目可行性进行论证,该等分析论证均基于当时的市场环境、业务状况。项目实施需要一定周期,若前述因素发生重大变化,包括但不限于宏观和市场环境、下游客户需求、产品市场价格、供应链保障、技术

路线、产业政策、项目管理、核心团队等，或募投项目所需的其他资金来源无法及时到位，均可能影响项目进度或导致项目实际效益不及预期。

公司实施本次募投项目将新增固定资产在内的投资支出。项目建成后将新增研发、折旧、摊销费用。若未来募集资金投资项目效益不及预期，可能对公司经营业绩构成不利影响。提请投资者注意相关风险。

(2) 发行上市失败的风险

公司本次首次公开发行股票并上市的结果受宏观环境、股票市场情况、行业发展情况、公司经营状况、投资者对行业及公司价值判断等因素影响。若前述因素发生重大不利变化，可能存在公司本次发行或上市中止甚至终止的风险。提请投资者注意相关风险。

(3) 其他

除上述风险因素外，投资者在评价公司本次发行的股票时，还应特别考虑即期回报摊薄、净资产收益率下降、股票价格较大波动、不可抗力等风险。提请投资者注意相关风险。

二、申请上市股票的发行情况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次拟公开发行人民币普通股（A 股）股票（行使超额配售选择权之前）不低于 198,000.00 万股且不超过 243,000.00 万股、占公司发行后总股本比例不低于 10%且不超过 12%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（行使超额配售选择权之前）的 15.00%
每股面值	人民币 1.00 元
拟上市证券交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不低于 1,980,000.00 万股且不超过 2,025,000.00 万股（行使超额配售选择权之前）
联席保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定张明慧、张欢作为长存控股首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定吴玉立作为项目协办人，指定王凯、胡璇、梅俊凯、刘晟明、郝嘉耕、于棚土、胡锺峻、蒋子晗、廖旭、潘竞鑫、李弘麟、陈俊杰、李

永深、王帅、张子欧、鲁培、张锦沛、王风雷作为项目组成员。

（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

张明慧，女，保荐代表人，现任中信证券股份有限公司总监，曾负责或参与北京航空材料研究院股份有限公司 IPO 项目、沈阳富创精密设备股份有限公司 IPO 项目、中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 IPO 项目、合肥江航飞机装备股份有限公司 IPO 项目、第一拖拉机股份有限公司 IPO 项目、西藏华钰矿业股份有限公司 IPO 项目、中国航发动力控制股份有限公司非公开项目、中国船舶重工股份有限公司非公开项目、武汉东湖高新集团股份有限公司可转债项目、中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司可转债项目、中航航空电子系统股份有限公司可转债项目、航天晨光股份有限公司非公开项目、中金黄金股份有限公司配股项目、中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司重大资产重组项目、中航电测仪器股份有限公司重大资产重组项目、中国船舶重工集团动力股份有限公司 2022 年重大资产重组项目、中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产项目、中国船舶重工股份有限公司重大资产重组项目、中国船舶重工集团动力股份有限公司 2020 年重大资产重组项目、中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司重大资产重组项目、中国船舶重工集团动力股份有限公司 2016 年重大资产重组项目、包头北方创业股份有限公司重大资产重组项目、湖南江南红箭股份有限公司重大资产重组项目、中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司重组上市项目等。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张欢，男，保荐代表人，现任中信证券股份有限公司执行总经理，曾负责或参与的项目包括上海燧原科技股份有限公司 IPO 项目、江苏鲁汶仪器股份有限公司 IPO 项目、西安奕斯伟材料科技股份有限公司 IPO 项目、沈阳富创精密设备股份有限公司 IPO 项目、有研半导体硅材料股份公司 IPO 项目、中信金属股份有限公司 IPO 项目、中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 IPO 项目、山东新巨丰科技包装股份有限公司 IPO 项目、江苏共创人造草坪股份有限公司 IPO 项目、天津七一二通信广播股份有限公司 IPO 项目、中铝国际工程股份有限公司 IPO 项目、厦门钨业股份有限公司非公开发行股票项目、武汉华中数控股份有限公司非公开发行股票项目、南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票项目、

深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票项目、中信重工机械股份有限公司发行股份购买资产并配套融资项目、中金黄金股份有限公司配股项目、中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票项目、中国石油化工股份有限公司销售板块引战混改项目、中信证券（浙江）分立重组项目等 A 股项目以及北京奕斯伟计算技术股份有限公司 H 股 IPO 项目、山东天岳先进科技股份有限公司 H 股 IPO 项目、徽商银行股份有限公司 H 股 IPO 项目、昆山丘钛微电子科技股份有限公司港股 IPO 项目、中国信达资产管理股份有限公司 H 股 IPO 项目等港股项目等。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

吴玉立，男，博士，曾任中信证券股份有限公司宏观经济高级分析师，连续 5 年荣登新财富最佳分析师榜单。现任投行工业与先进制造行业组执行总经理，国企改革组负责人、国企混改专家、市值管理专家。曾主持和负责长存控股融资财务顾问项目、长存控股股权激励财务顾问项目、长存资本设立与常年财务顾问项目、武汉新芯融资财务顾问项目、上海宏茂微电子股权优化财务顾问项目、徐工集团混改与重大资产重组项目、柳工集团混改与重大资产重组项目、北京电控集团综合改革财务顾问项目等。牵头诚通央企结构调整指数 ETF 以及四川国资发展指数 ETF 项目，国新投资常年财务顾问与市值管理项目，与中信证券研究部合作发布《上市公司市值管理手册》等。

（三）本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员自愿接受上海证券交易所自律监管的承诺

本次证券发行上市的保荐代表人张明慧和张欢、协办人吴玉立及项目组其他成员自愿接受上海证券交易所自律监管的承诺如下：

“本人将遵守法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所对推荐证券上市的规定，自愿接受上海证券交易所的自律监管措施。”

四、保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明

（一）本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

1、截至 2026 年 3 月 31 日，芯飞科技上层股东中信银行股份有限公司与本次发行上市保荐人（主承销商）中信证券、中信建投存在关联关系，中信银行股份有限公司间接持有发行人 4.45%的股份。

2、截至 2026 年 3 月 31 日，中信证券全资子公司中信证券投资有限公司持有发行人参股企业长存产业基金 2.45%的合伙份额。

3、截至 2026 年 3 月 31 日，中信证券全资子公司中信证券投资有限公司持有发行人参股公司武汉新芯 0.53%的股份。

除上述情况外，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其主要股东、重要关联方股份。

本保荐人将按照上交所相关规定参与本次发行战略配售，保荐人及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。

（二）发行人或其重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至本上市保荐书签署日，发行人或重要关联方未持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、审计委员会成员、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、审计委员会成员、高级管理人员不存在持有发行人权益及在发行人处任职等情况。

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人的主要股东、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人主要股东、重要关联方不存在相互提供异于正常商业条件的担保或者融资等情况。

（五）除上述情形外，保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本上市保荐书签署日，保荐人及其保荐代表人不存在对其公正履行保荐职责可能产生影响的事项。

五、保荐人承诺事项

（一）保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。保荐人同意推荐长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。

（二）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十五条的规定，中信证券作出如下承诺：

1、保荐人有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定。

2、保荐人有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、保荐人有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。

4、保荐人有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。

5、保荐人保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。

6、保荐人保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、保荐人保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范。

8、保荐人自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施，自愿接受上海证券交易所的自律监管。

六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序

（一）董事会

2026 年 8 月 18 日，发行人召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》等相关议案。

（二）股东会

2026 年 8 月 18 日，发行人召开了 2026 年第四次股东会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》等相关议案。

综上，保荐人认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效。

七、保荐人关于发行人符合科创板定位要求的核查意见

（一）发行人符合科创板定位要求的具体情况依据

1、发行人符合科创板行业领域要求

公司所属行业领域	☒ 新一代信息技术	公司是一家集芯片设计、晶圆制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的半导体存储器 IDM 企业。 根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》和中国证监会《上市公司行业统计分类与代码（JR/T 0020-2024）》，公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。 根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为战略性新兴产业分类中“电子核心产业”中的“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）。 根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司所处行业为“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”。
	☐ 高端装备	
	☐ 新材料	
	☐ 新能源	
	☐ 节能环保	
	☐ 生物医药	
	☐ 符合科创板定位的其他领域	

2、发行人符合科创属性相关指标要求

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上，或者最近三年研发投入金额累计在 8,000 万元以上	是	2023 年至 2025 年，公司累计研发投入为 141.89 亿元、超过 8,000 万元，累计研发投入占同期累计营业收入的比例超过 5%
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	是	截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 4,704 人，研发人员数量占当年员工总数的比例超过 10%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	是	截至 2026 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司（不包括武汉新芯及其控制的企业）已获授权发明专利共计 5,611 项，广泛应用于公司的主营业务，应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利超过 7 项
最近三年营业收入复合增长率达到 25%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元	是	2025 年，公司实现营业收入 631.85 亿元、超过 3 亿元，最近三年营业收入复合增长率超过 25%

（二）保荐人核查过程及意见

1、访谈发行人研发部门负责人和核心技术人员，实地勘察发行人的研发场所和研发设备，查阅发行人研发管理相关制度等文件，了解发行人在研项目情况，核查发行人研发投入相关凭证；

2、了解公司主要产品的所属行业、下游应用领域、技术性能指标、研发方向及阶段、核心技术水平，查阅行业分类和行业研究报告，证实发行人主要产品属于新一代信息技术领域；

3、取得并查阅公司与主要客户签署的销售合同、订单等文件，并对主要客户进行了走访，了解发行人产品的市场定位、技术水平、合作进展及应用前景；

4、查阅发行人员工花名册、研发部门架构、研发人员资历、研发人员界定标准等资料，调查发行人的研发模式和研发系统的设置和运行情况，查阅发行人报告期内研发项目资料，并核查研发人员薪酬情况及其费用归集情况；

5、访谈发行人的研发负责人，了解发行人的核心技术体系、技术原理、核心技术产品的性能表现，通过现场核查、网络核查等方式，核查发行人列报的专利权利归属、有效期限、有无权利受限或诉讼纠纷以及在核心技术中的应用情况；

6、结合发行人经审计的财务报告、业务合同主要条款、同行业可比公司情况及会计准则规定，通过穿行测试、发行人访谈、客户访谈、发询证函、现场核

查等方式，核查发行人收入确认会计政策的合理性及执行的有效性、发行人营业收入的增长情况。

经核查，保荐人认为发行人属于“新一代信息技术”行业领域，属于战略性新兴产业，符合国家科技创新战略；发行人拥有关键核心技术，科技创新能力突出，多项核心技术和产品达到国际领先和国际先进水平，符合相关法律法规中对科创属性和科创板定位要求。

八、保荐人对发行人是否符合科创板上市条件的说明

公司股票上市符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件，具体情况如下：

（一）发行人符合证监会规定的发行条件

1、发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十条的规定

经核查发行人的发起人协议、公司章程、发行人工商档案、《营业执照》等有关资料，保荐人认为，发行人系根据《公司法》在中国境内设立的股份有限公司，发行人的设立以及其他变更事项已履行了必要批准、验资、工商注册及变更登记等手续，发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司。经核查发行人设立登记及历次工商变更的证明文件，发行人于 2016 年 12 月 21 日完成有限责任公司设立，并于 2025 年 9 月 25 日整体变更为股份有限公司，保荐人认为，发行人持续经营时间已在 3 年以上。

经核查发行人历次股东会、董事会和监事会的会议文件，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度，发行人自设立为股份有限公司以来已依据《公司法》等法律法规设立了股东会、董事会和监事会，在董事会下设置了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并建立了《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等相关制度，建立健全了管理、生产、销售、财务、研发等内部组织机构和相应的内部管理制度。2026 年 7 月 30 日，发行人召开 2026 年第二次股东会，同意不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。保荐人认为，发行人具备健全且运行良好

的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

2、发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告；发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条的规定

根据发行人的相关财务管理制度以及德勤会计师出具的标准无保留意见的《长江存储控股股份有限公司财务报表及审计报告》（德师报（审）字（26）第 S00633 号），并核查发行人的原始财务报表，保荐人认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量。

根据发行人的财务管理制度和内部控制制度、德勤会计师出具的《长江存储控股股份有限公司内部控制审计报告》（德师报（审）字（26）第 S00634 号），并核查发行人的内部控制流程及其运行效果，保荐人认为，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条的规定

（1）经核查发行人业务经营情况、主要资产、专利、商标、计算机软件著作权等资料，并结合对发行人董事和高级管理人员的访谈等资料。保荐人认为，发行人资产完整，资产、人员、财务、机构、业务独立，未发现存在与主要股东及其控制的其他企业间对发行人构成重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易情形。

（2）经核查发行人历次股东会、董事会会议文件，并核查发行人的实际经营情况，保荐人认为，发行人最近二年内主营业务收入来源主要为 NAND Flash 产品，主营业务没有发生重大变化。

经核查发行人历次聘请董事、高级管理人员的股东会决议及董事会决议，发行人最近二年内董事、高级管理人员没有发生重大不利变化。

自公司成立以来，公司股东所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，报告期内，公司不存在实际控制人。

(3) 经核查发行人财产清单、主要资产的权属证明文件等资料，结合与发行人管理层的访谈，并根据发行人律师所出具的《法律意见书》，保荐人认为，发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条的规定

经核查发行人的《营业执照》、主要业务合同、所在行业管理体制和行业政策，取得的工商、税务、社会保障及住房公积金等方面的主管机构出具的有关证明文件，并进行公开信息查询，保荐人认为，最近三年内，发行人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

经核查发行人董事和高级管理人员提供的调查表、无犯罪记录证明及其分别出具的相关承诺，并核查股东会、董事会、审计委员会运营记录，公司董事、审计委员会委员和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。

(二) 公司发行后的股本总额不低于人民币 3,000 万元

公司发行后的总股本不低于 1,980,000.00 万股且不超过 2,025,000.00 万股（行使超额配售选择权之前），符合发行后的股本总额不低于人民币 3,000 万元。

(三) 公司股本总额超过 4 亿元，公开发行股份的比例为 10%以上

本次发行前公司总股本为 1,782,000.00 万股，股本总额超过 4 亿元；公司本次拟公开发行股份不低于 198,000.00 万股且不超过 243,000.00 万股（行使超额配售选择权之前），占公司发行后总股本比例不低于 10%且不超过 12%，符合公开发行股份的比例为 10%以上。

（四）市值及财务指标符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的标准

公司选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2 条的第四项上市标准，即“（四）预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”，具体情况如下：

1、市值结论

根据报告期内最近一次外部股权融资情况、可比 A 股上市公司二级市场估值情况和基于公司的经营业绩及财务状况，预计市值不低于 30 亿元。

2、财务指标

公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-3 月实现营业收入分别为 1,874,380.21 万元、4,520,321.51 万元、6,318,462.42 万元和 4,704,231.49 万元，公司最近一年营业收入超过 3 亿元。

3、标准适用判定

公司结合自身规模、经营情况、盈利情况等因素，选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2 条的第四项上市标准，即“（四）预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。

综上所述，公司符合所选择的上市标准。

（五）保荐意见

本保荐人根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》等法规的规定，对发行人进行了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审，认为：

发行人具备《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条件，发行人行业领域归类 and 科创属性符合科创板定位要求；发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，经营业绩优良，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目符合发行人的经营发展战略，有利于推动发行人持续稳定发展。因此，本保荐人同意对

发行人首次公开发行股票并在科创板上市予以保荐。

九、保荐人对发行人持续督导工作的安排

发行人股票上市后，保荐人及保荐代表人将根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，尽责完成持续督导工作。持续督导期为发行上市当年以及其后三年，持续督导工作计划具体如下：

持续督导事项	工作计划
1、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件	1、督导发行人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务 2、在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件
2、督导发行人有效执行并完善防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度
3、督导发行人有效执行并完善防止其董事、审计委员会委员、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度	督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事、审计委员会委员、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	1、督导发行人有效执行并进一步完善《公司章程》《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度 2、督导发行人及时向保荐人通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	1、督导发行人执行发行上市后所适用的募集资金相关的管理制度，保证募集资金的安全性和专用性 2、持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项 3、如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐人要求发行人通知或咨询保荐人，并督导其履行相关信息披露义务
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	1、督导发行人执行已制定的《融资与担保管理制度》等制度，规范对外担保行为 2、持续关注发行人为他人提供担保等事项
7、中国证监会、上海证券交易所及保荐协议约定的其他工作	根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定约定的其他工作，保荐人将持续督导发行人规范运作

十、保荐人认为应当说明的其他事项

无其他应当说明的事项。

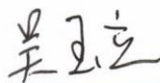
十一、保荐人对本次股票上市的推荐结论

保荐人中信证券股份有限公司认为，发行人长江存储控股股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定，发行人股票具备在上交所科创板上市的条件，同意推荐发行人在上交所科创板上市。

（以下无正文）

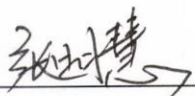
(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页)

项目协办人：

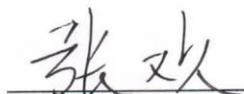


吴玉立

保荐代表人：

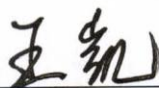


张明慧



张 欢

保荐业务部门负责人：



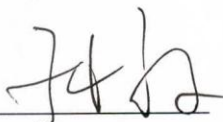
王 凯

内核负责人：



邱志千

保荐业务负责人：



孙 毅

中信证券股份有限公司



2026 年 8 月 20 日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页）

董事长、法定代表人：


张佑君

中信证券股份有限公司

2026 年 8 月 20 日



中信建投证券股份有限公司

关于

**长江存储控股股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市**

之

上市保荐书

保荐人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二六年八月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人关峰、包红星已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

目 录

一、发行人基本情况.....	3
二、发行人本次发行情况.....	12
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式.....	13
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.....	15
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项.....	16
六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明.....	17
七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程.....	17
八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明.....	19
九、持续督导期间的工作安排.....	22
十、保荐人关于本项目的推荐结论.....	23

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称	长江存储控股股份有限公司
英文名称	CCSH Corporation
注册资本	1,782,000.00 万元
法定代表人	陈南翔
有限公司成立日期	2016 年 12 月 21 日
股份公司成立日期	2025 年 9 月 25 日
公司住所	武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 1701 室
邮政编码	430205
联系电话	027-65529696
传真号码	027-65529697
互联网网址	www.ccsb.com
电子信箱	ir@ccsb.com
信息披露和投资者关系负责部门、负责人及联系方式	董事会办公室，李刚，027-65529696

（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

1、发行人的主营业务

公司是代表中国跻身世界一流的存储器 IDM 企业，打造全球领先层数、高存储密度、高 I/O 速度的 NAND Flash 系列产品，广泛应用于企业服务器、数据中心、消费电子等领域。依托中国庞大的应用市场和国际化布局，报告期内公司出货量快速增长。根据 TrendForce 数据计算，2026 年 1-3 月公司在全球 NAND Flash 厂商中按销售金额和出货量排名，均位列全球第三、中国第一。

公司始终坚持原创核心技术攻关，引领我国 3D NAND 技术赶超国际先进水平。公司 2022 年推出 Xtacking®3.0 技术，获得全球存储领域权威峰会 FMS “最具创新存储技术奖”，成为全球首批推出 200 层以上 3D NAND Flash 产品的企业，实现国内存储技术首次领先世界先进水平；2024 年迭代 Xtacking®4.0 技术，次年再度获得 FMS 权威奖项，重塑全球 3D NAND 技术发展路线；2025 年成为中国大陆为数不多的与国际头部厂商达成专利交叉授权的集成电路企业，技术影响力凸显。

公司已构建多元高质量客户体系，实现多维度、多层级市场覆盖。在企业用户市场，公司与国内互联网、服务器、消费电子等领域头部企业深度合作，同时切入国际一流客户供应体系。在个人用户市场，公司推出自有品牌致态®系列产品，品牌知名度与市场影响力持续提升。

存力是数字时代的基石，是数字基建的核心载体。公司以终端应用为牵引，持续构建高商业价值产品组合，支撑各细分领域、应用场景多元需求。同时，公司为上游材料、设备、零部件厂商提供应用验证场景，与上下游商业伙伴共同推动全产业链技术迭代、工艺升级，做大做强中国存储器产业，以科技创新服务回馈社会。

2、发行人的核心技术

公司作为代表中国跻身世界一流的存储器 IDM 企业，核心技术覆盖 NAND Flash 产品设计、工艺、封测等环节，具有独立自主的技术路线和技术体系。

公司具有代表性的核心技术主要包括 3D NAND 晶圆技术和 3D NAND 产品技术，核心技术具体情况如下：

(1) 3D NAND 晶圆技术

序号	类别	技术名称	技术概况及先进性表征	先进性	专利
1	3D NAND 技术	Xtacking®架构技术	全球首创 Xtacking®架构，依托分合、共享、重构与正反的核心理念，在 Xtacking®架构 1.0~4.0 的演进过程中实现了异质集成、同质多堆栈堆叠、晶背信号与电源引出、无台阶自对准字线引出多项架构创新，从本质上解决了氢热耦合矛盾和超高层工艺集成难题，开辟了三维闪存技术新路径，为 3D NAND 闪存迈向更高层提供了核心技术支撑。其中： ①异构集成是将存储阵列与外围电路通过异质混合键合集成，采用新型铜机械研磨工艺、背面应力补偿工艺与光刻修正技术，开发新型绝缘介质材料，实现了百亿根铜通孔亚微米级对准精度的互连，键合密度领先业界同期一个数量级； ②同质多堆栈阵列架构解决刻蚀设备能力不足的问题，在同等设备能力下存储密度大幅提升； ③晶背信号与电源引出将三维架构底部的复杂三维工艺变为平面工艺，显著降低了集成难度和制造成本，解除了垂直深槽底部立体工艺对三维闪存向更高层数堆叠发展的限制； ④无台阶自对准字线形成与引出架构，通过自对准接触孔代替传统台阶字线引出技术，解决传统架构中台阶字线引出在向更高层数迭代中导致的平面存储面积损失和多维工艺牵制问题，显著提升存储密度； 获得未来内存与存储峰会（FMS）“最具创新存储技术奖”；全球闪存峰会（FMW）“闪存存储创新产品特别奖”；中国闪存市场峰会（CFMS）“最佳技术突破奖”。	国际领先	发明专利 2,000 项以上
2	MLC 3D NAND	多阶存储单元调控技术	自主研发了多阶存储单元调控技术，针对纳米尺度多叠层栅介质结构进行原子级精准调控，解决电荷俘获器件基础科学问题，控制数据失效比在极低水平，实现 2bit 存储，应用于第一代 3D NAND 产品。	国际先进	发明专利 350 项以上
3	TLC 3D NAND	栅堆栈能带调控理论方法	通过引入栅堆栈能带调控理论方法，有效解决了层数增加带来的层间耦合效应，显著提升了产品可靠性，实现 3bit 存储，应用于第二至第五代 3D NAND 产品。	国际先进	
4	QLC 3D NAND	新型自适应编程、阶梯式电势调控等阵列操作算法	创新性的提出新型自适应编程、阶梯式电势调控等阵列操作算法，有效解决了存储阵列连接区的器件串扰问题，实现 4bit 存储。应用于第三至第五代 3D NAND 产品。	国际先进	

(2) 3D NAND 产品技术

序号	类别	技术名称	技术概况及先进性表征	先进性	专利
1	硬件设计	硬件电路设计与可靠集成技术	在供电方案、备电电路、大容量架构、高速接口、高速高密互连、极限尺寸结构堆叠、热设计及可靠性设计等方向，沉淀了丰富的标准电路和成熟设计方案，保障 UFS、SSD 等产品硬件设计完整可靠。具备完善的多物理场联合仿真技术，高效破解信号传输、电磁兼容、散热、机械环境适配等各类技术难题，推动产品硬件综合性能与可靠性达到国际一流水平。	国际先进	发明专利 10 项以上
2	嵌入式	嵌入式 eMMC、UFS 产品技术	通过写入增强技术，主机缓存加速，多级自主优化等定制化固件设计，依托从控制器定制化到 NAND 特性级别的优化，提升产品存储效率和性能。通过自主研发的多模态低功耗模式，显著降低产品功耗。自主开发 UFS2.2、UFS3.1、UFS4.1 等多款产品。	国际先进	发明专利 20 项以上
3	消费级	消费级 PCIe Gen4、Gen5 产品技术	拥有行业领先的 PCIe 无缓（DRAM-less）SSD 软硬件设计，包括高顺序读写性能设计、低功耗策略、主机缓存方案（HMB）、冗余数据保护（RAID）算法等多项核心技术，实现办公、影音、游戏等多场景和高负载、冷启动等多工作模式下的性能优化，持续推出 PC411、PC450、PC41Q、PC550 等多款 OEM 商用消费级产品，产品性能同代领先。	国际先进	发明专利 20 项以上
4	企业级	企业级 PCIe Gen4、Gen5 产品技术	针对企业级高稳定性、高可靠性需求，拥有一系列介质优化算法如谷底电压搜索、数据保持刷新、纠错流程等算法，使闪存颗粒在性能、数据可靠性等方面发挥出最佳特征。 具备体系化的功耗评估模型和功耗优化方法论，通过一系列创新的硬件设计和散热结构的优化，配合固件算法，实现行业领先的功耗管理。 基于 Xtacking®4.0 架构 3D NAND 推出 PCIe Gen5 高性能企业级 SSD 产品，具备行业领先的性能和可靠性设计。	国际先进	
5	封装	多层堆叠封装技术	通过多层堆叠封装技术（DDP/QDP/ODP/HDP/32DP），实现单颗粒容量涵盖 512GB~8TB。其中通过晶圆厚度减薄及精准切割技术实现两位数芯片堆叠封装，为目前业界最大容量存储芯片封装，且封装后产品实现业界体积最小。广泛应用于智能手机、电脑、企业级服务器，互联网设备等场景。	国内领先	发明专利 160 项以上

3、发行人的研发水平

(1) 主要荣誉奖项

截至 2026 年 3 月 31 日，公司获得的主要荣誉、奖项情况如下：

获得时间	获奖主体	颁发部门	荣誉名称
2026 年 3 月	长江存储	中国闪存市场峰会（CFMS）	年度技术创新奖
2025 年 8 月	长江存储	未来内存与存储峰会（FMS）	最具创新存储技术奖
2025 年 5 月	长江存储	德国红点奖委员会	红点设计奖
2025 年 3 月	长江存储	中国电子学会	技术发明奖特等奖
2025 年 3 月	长江存储	中国闪存市场峰会（CFMS）	年度闪存技术创新奖
2025 年 3 月	长江存储	国际半导体产业协会	可持续发展卓越贡献奖
2024 年 3 月	长江存储	中国闪存市场峰会（CFMS）	年度技术突破奖
2023 年 3 月	长江存储	中国闪存市场峰会（CFMS）	最佳技术突破奖、最佳行业价值贡献奖
2022 年 8 月	长江存储	世界闪存峰会（FMS）	最具创新存储技术奖
2021 年 9 月	长江存储	中国闪存市场峰会（CFMS）	最佳市场突破奖
2021 年 7 月	长江存储	全球闪存峰会（FMW）	十大固态硬盘企业金奖、闪存存储创新产品特别奖
2018 年 9 月	长江存储	中国闪存市场峰会（CFMS）	最佳技术创新奖
2018 年 8 月	长江存储	世界闪存峰会（FMS）	最具创新初创闪存企业奖
2022 年 10 月	宏茂微	上海市科学技术委员会	上海市科技小巨人企业

(2) 重大科研项目及主要在研项目

自成立以来，公司牵头或参与了多个重大科研项目。截至 2026 年 3 月 31 日，公司主要在研项目情况如下：

序号	名称	所处阶段	研发目标
1	第六代三维闪存系列产品研发项目	研发阶段	完成公司多个第六代三维闪存产品研发
2	三维闪存系统解决方案产品研发系列项目	研发阶段	进一步完善公司系统解决方案产品固件和硬件技术平台，并基于公司第五代三维闪存产品，开发具有更高性能、更低延迟、更大容量、更低功耗的存储器产品，包括：①面向企业级服务器的 PCIe Gen5 和 SATA eSSD 产品等；②面向消费电子领域的 PCIe Gen5 cSSD 产品、UFS3.1 和 UFS4.1 嵌入式存储产品等

(3) 研发投入情况

报告期内，公司保持较高的研发投入水平，研发投入及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年	2024 年	2023 年
研发投入	176,312.62	558,459.15	429,438.65	431,048.67
营业收入	4,704,231.49	6,318,462.42	4,520,321.51	1,874,380.21
研发投入占比营业收入	3.75%	8.84%	9.50%	23.00%

（4）合作研发情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司不存在正在从事的重要合作研发项目。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

单位：万元

项目	2026.3.31/ 2026 年 1-3 月	2025.12.31/ 2025 年	2024.12.31/ 2024 年	2023.12.31/ 2023 年
资产总额	26,158,847.11	22,839,616.25	21,102,416.29	19,787,856.63
归属于母公司所有者权益	13,577,750.41	10,236,556.13	8,608,153.04	7,576,074.55
资产负债率（合并）	43.65%	50.14%	56.83%	61.30%
资产负债率（母公司）	0.90%	0.72%	0.06%	0.11%
营业收入	4,704,231.49	6,318,462.42	4,520,321.51	1,874,380.21
归属于母公司所有者净利润	3,337,887.88	1,421,073.80	677,074.52	-1,918,064.00
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者净利润	3,317,215.49	1,330,909.72	622,964.02	-1,935,986.21
基本每股收益（元/股）	1.87	0.80	0.39	-1.23
稀释每股收益（元/股）	1.87	0.80	0.39	-1.23
加权平均净资产收益率	28.03%	15.08%	8.23%	-27.68%
经营活动产生现金流量净额	2,674,405.47	3,268,357.89	2,172,071.60	98,869.76
现金分红	-	-	-	-
研发投入占比营业收入	3.75%	8.84%	9.50%	23.00%

（四）发行人存在的主要风险

1、经营风险

（1）人才短缺或流失风险

半导体存储器行业属于人才密集型产业，具有丰富行业经验的研发、生产、

采购、销售、运营管理团队是公司保持竞争力的关键。在国家政策大力支持下，我国集成电路产业蓬勃发展，对优秀人才需求与日俱增。未来，若公司核心团队流失、优秀人才短缺或人员能力未能匹配公司业务发展需要，可能对公司业务开展造成不利影响。提请投资者注意相关风险。

（2）商业秘密泄露风险

半导体存储器行业属于技术密集型产业，核心技术、制造工艺等商业秘密是公司保持竞争优势的关键因素。虽然公司已建立较为完善的知识产权保护体系和严格的保密制度，但考虑到全球存储芯片行业激烈竞争背景、商业秘密保护措施的限制性、人员流动等其他不可控因素，公司商业秘密仍存在泄露风险。如该等情况发生，将对公司市场竞争力造成不利影响。提请投资者注意相关风险。

（3）产能区域集中度较高风险

公司是集芯片设计、晶圆制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的存储器 IDM 企业，在多地设有产研基地。基于半导体产业集聚发展、配套协同优化、降低运营成本、提升生产协同效率的布局逻辑，截至本上市保荐书签署日，公司核心晶圆制造产能相关的主要经营性资产均位于武汉区域，地理分布距离近、区域集中度较高。若未来公司核心晶圆产能所处地区的电力、能源、水等资源供应、环保或安全生产、公共配套保障、区域性公共突发事件、不可预测的灾害（如地震、洪涝、火灾等）等出现不利情形，可能导致制造流程中止甚至精密设备损坏，从而可能带来产能及产能利用率波动、产品交付延期、生产运营成本上升等问题。提请投资者注意相关风险。

2、财务风险

（1）持续高额投入风险

存储芯片行业具有持续高投入特点。存储芯片行业产品、技术、工艺迭代速度较快，企业需对行业发展趋势、产品布局、技术路线进行预判并以巨额资金投入前瞻性研发。报告期内，公司累计研发支出约 159.53 亿元。同时，产品供应能力和价格是核心竞争因素，规模效应是降低单位成本的主要手段之一。报告期内，公司购建长期资产累计现金支出约 963.90 亿元。但公司产能规模与国际存

储巨头仍存在差距，未来一段时间仍需保持高额产能建设及产线升级投入，投产后将产生高额折旧摊销费用。报告期内，公司折旧及摊销费用合计约 509.49 亿元，为营业成本和期间费用的主要构成部分。

若公司未能从生产经营或其他渠道获得足够资金，可能无法支撑公司前述持续高额投入需求。若未来公司不能及时推出在性能、质量、成本等方面具有综合竞争力的产品，或研发方向出现误判、产品和工艺迭代速度不及预期，将可能在激烈的市场竞争中落后于国际巨头并丧失市场份额。若未来存储芯片技术、市场需求等因素发生重大不利变化，亦可能导致公司花费巨额投入的新产品、新技术、新工艺、新产能无法实现预期商业效益，进而对公司经营业绩造成不利影响。提请投资者注意相关风险。

（2）价格及毛利率波动和下滑风险

历史上存储芯片行业受供需影响具有周期性波动特点。需求端，下游主要应用领域受技术迭代、国内外经济状况、消费水平、新兴产业发展等因素影响；供给端，存储芯片行业集中度高，产能建设投资大，产能释放和压降需要一定周期，主要供应商产能调整可能对市场供应量构成较大影响。产能集中释放可能在短期内导致市场供给过剩，进而引发产品单价下跌。同时规模庞大且相对稳定的折旧摊销费用将在一定程度上放大单价波动对毛利率及净利润的影响。

截至本上市保荐书签署日，全球 NAND Flash 市场处于供不应求的高景气周期，公司毛利率及净利润规模随之快速上升。但 NAND Flash 市场高景气度持续时间存在不确定性。当市场需求增速放缓或主要存储厂商快速扩产及重新调配产能导致供给大幅增加时，产品价格可能出现回落。同时，公司直面与国际巨头的激烈竞争，国内外经济形势、产品技术发展状况、原材料及设备供应情况、地缘政治等多方面因素均可能影响公司业绩表现，导致公司毛利率、净利润水平明显波动、甚至亏损。提请投资者注意相关风险。

（3）存货减值风险

报告期内，公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额分别为 113.53 亿元、1.16 亿元、6.93 亿元和 2.49 亿元。若未来出现客户违约，或产品价格显著下降等情况，可能导致公司需计提大额存货跌价准备。提请投资者注意相关风

险。

3、合规和法律风险

（1）安全生产风险

公司产品制造过程涉及近千步工艺步骤，需使用具有一定危险性的材料及气体。公司高度重视并已建立了严格的安全生产、健康与环境管理制度、规范及体系，对厂区内人员开展系统性培训，但仍存在相关制度执行不到位发生意外事故、故障等风险。提请投资者注意相关风险。

（2）环境保护风险

公司生产过程涉及产生废气、废水、固体废物等污染物。公司拥有相匹配的环保装置和防护措施，报告期内整体运行情况良好。但如未来环保设施运行发生意外故障或有关环境保护制度执行不到位等均可能导致环境污染事件。提请投资者注意相关风险。

（3）诉讼纠纷风险

半导体产业属于典型的知识产权密集型行业。公司坚持自主创新，高度重视公司知识产权及商业秘密。但全球存储芯片行业竞争激烈，涉及利益相关方较多，并受国际政治因素影响。国际巨头亦将知识产权诉讼、收取知识产权费用等作为竞争甚至创收手段之一。公司在经营过程中存在与竞争对手等相关方产生诉讼纠纷的可能。提请投资者注意相关风险。

4、地缘政治摩擦风险

存储芯片制造对原材料、设备及备品备件要求较高，全球半导体产业链已形成高度专业化协同分工体系。近年来国际贸易政策不稳定因素增加，若相关情况发生重大不利变化，可能对公司供应链和生产经营稳定性、产品成本控制以及海外市场开拓等方面造成不利影响。提请投资者注意相关风险。

5、募投项目相关风险

公司已对本次募集资金投资项目可行性进行论证，该等分析论证均基于当时的市场环境、业务状况。项目实施需要一定周期，若前述因素发生重大变化，包

包括但不限于宏观和市场环境、下游客户需求、产品市场价格、供应链保障、技术路线、产业政策、项目管理、核心团队等，或实施主体项目所需的其他资金来源无法及时到位，均可能影响项目进度或导致项目实际效益不及预期。

公司实施本次募投项目将新增固定资产在内的投资支出。项目建成后将新增研发、折旧、摊销费用。若未来募集资金投资项目效益不及预期，可能对公司经营业绩构成不利影响。提请投资者注意相关风险。

6、发行上市失败的风险

公司本次首次公开发行股票并上市的结果受宏观环境、股票市场情况、行业发展情况、公司经营状况、投资者对行业及公司价值判断等因素影响。若前述因素发生重大不利变化，可能存在公司本次发行或上市中止甚至终止的风险。提请投资者注意相关风险。

7、其他

除上述风险因素外，投资者在评价公司本次发行的股票时，还应特别考虑即期回报摊薄、净资产收益率下降、股票价格较大波动、不可抗力等风险。提请投资者注意相关风险。

二、发行人本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不低于 198,000.00 万股且不超过 243,000.00 万股（行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于 10%且不超过 12%（行使超额配售选择权之前）
其中：发行新股数量	不低于 198,000.00 万股且不超过 243,000.00 万股（行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于 10%且不超过 12%（行使超额配售选择权之前）
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不低于 1,980,000.00 万股且不超过 2,025,000.00 万股（行使超额配售选择权之前）		
每股发行价格	人民币【】元		
发行市盈率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收益按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）		

发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会、上交所认可的其他方式进行（包括但不限于向战略投资者定向配售）		
发行对象	符合中国证监会或上交所规定资格的战略投资者、询价对象以及符合投资者适当性要求且在上交所开立证券账户并开通科创板交易权限的境内自然人、法人和其他机构等投资者（法律法规、中国证监会部门规章或上交所业务规则等规定的禁止购买者除外），中国证监会或上交所等监管部门另有规定的，按其规定执行		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	长江存储量产线技术升级项目		
	研发相关募投项目		
发行费用概算	本次发行费用共计【】万元（不含增值税），其中承销及保荐费【】万元，审计及验资费【】万元，律师费【】万元，用于本次发行的信息披露费【】万元，用于本次发行的发行手续费及其他【】万元		
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若公司决定实施高级管理人员及员工战略配售，则公司将依据相关法律法规的要求，适时履行相应审议程序及其他相关所需程序，并依法进行披露		
保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件		

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式

（一）本次证券发行上市的保荐代表人

中信建投证券指定关峰、包红星担任长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

关峰先生：保荐代表人，非执业注册会计师，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：哈尔滨新光光电科技

股份有限公司 IPO 项目、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 IPO 项目、北京中亦安图科技股份有限公司 IPO 项目、永和流体智控股份有限公司 IPO 项目、苏州德龙激光股份有限公司 IPO 项目、苏州浩辰软件股份有限公司 IPO 项目、强一半导体（苏州）股份有限公司 IPO 项目；中航电测仪器股份有限公司重大资产重组项目、北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组项目、无锡华东重型机械股份有限公司重大资产重组项目、北京同有飞骥科技股份有限公司重大资产重组项目；歌尔股份有限公司向不特定对象公开发行可转债项目、通鼎互联信息股份有限公司向不特定对象公开发行可转债项目等。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：苏州铁近机电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

包红星先生：保荐代表人，非执业注册会计师、具有法律职业资格，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：联芸科技（杭州）股份有限公司 IPO 项目、安徽芯动联科微系统股份有限公司 IPO 项目、陕西华秦科技实业股份有限公司 IPO 项目、中铁高铁电气装备股份有限公司 IPO 项目、哈尔滨新光光电科技股份有限公司 IPO 项目、上海数据港股份有限公司 IPO 项目、湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目、北京中航泰达环保科技有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目、天壕环境股份有限公司向不特定对象公开发行可转债项目、引力传媒股份有限公司非公开发行股票项目、天康生物股份有限公司非公开发行股票项目、深圳市奋达科技股份有限公司重大资产重组项目、无锡华东重型机械股份有限公司重大资产重组项目等。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：联芸科技（杭州）股份有限公司非公开发行股票项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行上市项目协办人

郭炜先生：现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：厦门恒坤新材料科技股份有限公司 IPO 项目、西部超导材料科技股份有限公司 IPO 项目、西安铂力特增材技术股份有限公司 IPO 项目、苏州德龙激

光股份有限公司 IPO 项目、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 IPO 项目、顾家家居股份有限公司 IPO 项目、杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目、上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目、上海创远仪器技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目、常州同惠电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目、杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票项目、奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象公开发行可转债项目、杭州高新材料科技股份有限公司控股权收购项目、浙江中国小商品城集团股份有限公司国有股权无偿划转项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）本次证券发行上市项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括张林、林天、蔡怡希、方立、史翌、李恒、田建斌、王嘉琪。

（四）联系地址、电话和其他通讯方式

保荐人（主承销商）：	中信建投证券股份有限公司
联系地址：	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层
邮编：	100026
联系电话：	010-56051430
传真：	010-56160130

四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

（一）截至 2026 年 3 月 31 日，芯飞科技上层股东中信银行股份有限公司与本次发行上市保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司、中信建投证券存在关联关系，中信银行股份有限公司间接持有发行人 4.45% 的股份；

除上述情况外，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其主要股东、重要关联方股份；

本保荐人将按照上交所相关规定参与本次发行战略配售，保荐人及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件；

（二）除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至本上市保荐书签署日，发行人或重要关联方未持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

（三）截至本上市保荐书签署日，本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、审计委员会成员、高级管理人员不存在持有发行人权益及在发行人处任职等情况；

（四）截至本上市保荐书签署日，本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人主要股东、重要关联方不存在相互提供异于正常商业条件的担保或者融资等情况；

（五）截至本上市保荐书签署日，保荐人及其保荐代表人不存在对其公正履行保荐职责可能产生影响的事项。

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项

保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及上交所有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会、上交所规定的其他事项。

中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上交所对推荐证券上市的规定，自愿接受上交所的自律监管。

六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明

发行人已召开第一届董事会第八次会议以及 2026 年第四次股东会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》等相关议案。

经核查，本保荐人认为发行人已就本次发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定以及上交所的有关业务规则的决策程序。

七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程

（一）发行人符合板块定位及国家产业政策情况

1、发行人符合行业领域要求

公司所属行业领域	☒ 新一代信息技术	公司是一家集芯片设计、晶圆制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的半导体存储器 IDM 企业。 根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》和中国证监会《上市公司行业统计分类与代码（JR/T 0020-2024）》，公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。 根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为战略性新兴产业分类中“电子核心产业”中的“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）。 根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司所处行业为“新一代信息技术领域”中的“半导体和
	☐ 高端装备	
	☐ 新材料	
	☐ 新能源	
	☐ 节能环保	
	☐ 生物医药	
	☐ 符合科创板定位的其他领域	

		集成电路”。
--	--	--------

2、发行人符合科创属性相关指标要求

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上,或者最近三年研发投入金额累计在 8,000 万元以上	是	2023 年至 2025 年,公司累计研发投入为 141.89 亿元、超过 8,000 万元,累计研发投入占同期累计营业收入的比例超过 5%
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	是	截至 2025 年 12 月 31 日,公司拥有研发人员 4,704 人,研发人员数量占当年员工总数的比例超过 10%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	是	截至 2026 年 3 月 31 日,发行人及其控股子公司(不包括武汉新芯及其控制的企业)已获授权发明专利共计 5,611 项,广泛应用于公司的主营业务,应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利超过 7 项
最近三年营业收入复合增长率达到 25%,或最近一年营业收入金额达到 3 亿元	是	2025 年,公司实现营业收入 631.85 亿元、超过 3 亿元,最近三年营业收入复合增长率超过 25%

(二) 保荐人核查情况

1、核查程序

本保荐人履行了如下核查程序:

(1) 访谈发行人研发部门负责人和核心技术人员,实地勘察发行人的研发场所和研发设备,查阅发行人研发管理相关制度等文件,了解发行人在研项目情况,核查发行人研发投入相关凭证;

(2) 了解公司主要产品的所属行业、下游应用领域、技术性能指标、研发方向及阶段、核心技术水平,查阅行业分类和行业研究报告,证实发行人主要产品属于新一代信息技术领域;

(3) 取得并查阅公司与主要客户签署的销售合同、订单等文件,并对主要客户进行了走访,了解发行人产品的市场定位、技术水平、合作进展及应用前景;

(4) 查阅发行人员工花名册、研发部门架构、研发人员资历、研发人员界定标准等资料,调查发行人的研发模式和研发系统的设置和运行情况,查阅发行人报告期内研发项目资料,并核查研发人员薪酬情况及其费用归集情况;

(5) 访谈发行人的研发负责人,了解发行人的核心技术体系、技术原理、

核心技术产品的性能表现，通过现场核查、网络核查等方式，核查发行人列报的专利权利归属、有效期限、有无权利受限或诉讼纠纷以及在核心技术中的应用情况；

（6）结合发行人经审计的财务报告、业务合同主要条款、同行业可比公司情况及会计准则规定，通过穿行测试、发行人访谈、客户访谈、发询证函、现场核查等方式，核查发行人收入确认会计政策的合理性及执行的有效性、发行人营业收入的增长情况。

2、核查结论

经核查，本保荐人认为：发行人属于“新一代信息技术”行业领域，属于战略性新兴产业，符合科创板支持方向、科技创新行业领域和科创属性相关指标等科创板定位要求，符合国家产业政策的相关要求。

八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明

（一）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的发行条件”规定

1、发行人的设立时间及组织机构运行情况

本保荐人查阅了发行人的工商档案、有关主管部门出具的证明文件、纳税资料等。经核查，确认发行人前身长存有限成立于 2016 年 12 月，并于 2025 年 9 月整体变更为股份有限公司，自依法设立以来持续经营并合法存续，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十条的规定。

2、发行人财务规范情况

本保荐人查阅了德勤会计师出具的《审计报告》等相关财务资料，并取得了财务相关的内外部文件。经核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了标准无保留

意见的审计报告，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条第一款的规定。

3、发行人内部控制情况

本保荐人查阅了德勤会计师出具的内部控制审计报告以及发行人内部控制制度等资料。经核查，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审计报告，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条第二款的规定。

4、发行人资产完整性及业务、人员、财务、机构独立情况

发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立。发行人无控股股东、无实际控制人，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司构成同业竞争的情况。截至本上市保荐书签署日，发行人与持有公司 5%以上股份的主要股东及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第一款第（一）项的规定。

5、业务、控制权及管理团队的稳定性

发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近二年无实际控制人情形没有发生变更，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第一款第（二）项的规定。

6、对发行人持续经营有重大不利影响的事项

本保荐人查阅了发行人重要资产的权属证书、银行征信报告、德勤会计师出具的《审计报告》等资料，并查询了中国裁判文书网等公开网站信息。经核查，发行人不存在影响持续经营的主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项，符合《首次公开发行股票注册管理

办法》第十二条第一款第（三）项的规定。

7、发行人经营合法合规性

本保荐人查阅了发行人的《营业执照》《公司章程》及所属行业相关法律法规，生产经营所需的各项政府许可、权利证书或批复文件，访谈了发行人部分高级管理人员，实地察看了发行人生产经营场所，取得了发行人无违法违规的相关证明，经核查确认发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条第一款的规定。

8、发行人、实际控制人的守法情况

发行人无控股股东、无实际控制人。最近三年内，发行人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条第二款的规定。

9、董事、监事和高级管理人员的守法情况

发行人董事会设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，发行人不设监事会或者监事。本保荐人取得了发行人相关人员出具的调查表，并通过国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国证监会网站的证券期货市场失信记录查询平台进行查询。发行人董事、曾任监事、审计委员会委员、高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条第三款的规定。

综上所述，发行人符合中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件。

（二）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定

本次发行前，发行人的总股本为 1,782,000.00 万股，本次拟公开发行股份不低于 198,000.00 万股且不超过 243,000.00 万股（行使超额配售选择权之前），每

股面值为人民币 1.00 元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

（三）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定

本次发行前，发行人的总股本为 1,782,000.00 万股，本次拟公开发行股份不低于 198,000.00 万股且不超过 243,000.00 万股（行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后总股本的 10%且不高于本次发行后总股本的 12%，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

（四）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定及《上市规则》第 2.1.2 条之“（四）预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”规定

根据《上市规则》2.1.2 条，发行人选择的具体上市标准为“（四）预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。

根据发行人最近一次外部股权融资对应的估值以及可比 A 股上市公司二级市场估值情况，发行人的预计市值不低于 30 亿元，满足所选择上市标准中的市值指标。2025 年公司实现营业收入 631.85 亿元，超过 3 亿元。发行人市值和财务指标符合《上市规则》第 2.1.2 条的第四套标准。

（五）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（五）上海证券交易所规定的其他上市条件”规定

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

综上所述，保荐人认为：本次证券上市符合《上市规则》规定的上市条件。

九、持续督导期间的工作安排

发行人股票上市后，保荐人及保荐代表人将根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《科创板上市公司持续监管办法》等的相关规定，尽责完成持续督导工作。持续督导期为发行上市当年以及其后三年。

持续督导事项	工作计划
1、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	关注并审阅发行人的定期或不定期报告，关注新闻媒体涉及发行人的报道，督导发行人履行信息披露义务
2、督导发行人有效执行并完善防止关联方违规占用发行人资源的制度	根据相关法律法规，协助发行人制订、完善有关制度，并督导其执行
3、督导发行人有效执行并完善防止董事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程（草案）》的规定，协助发行人制定有关制度并督导其实施
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人的关联交易按照相关法律法规和《公司章程（草案）》等规定执行，对重大的关联交易，本机构将按照公平、独立的原则发表意见。发行人因关联交易事项召开董事会、股东会，应事先通知本保荐人，本保荐人可派保荐代表人参会并提出意见和建议
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、使用、投资项目的实施等承诺事项	定期跟踪了解投资项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东会，对发行人募集资金投资项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程（草案）》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定
7、中国证监会、证券交易所及保荐协议约定的其他工作	根据中国证监会、上交所有关规定以及保荐协议约定的其他工作，保荐人将持续督导发行人规范运作

十、保荐人关于本项目的推荐结论

本次发行上市申请符合法律法规和中国证监会及上交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐人中信建投证券认为：长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；中信建投证券同意作为长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 郭 炜
郭 炜

保荐代表人签名: 关 峰 包红星
关 峰 包红星

内核负责人签名: 徐子桐
徐子桐

保荐业务负责人签名: 刘乃生
刘乃生

法定代表人/董事长签名: 刘 成
刘 成

